



借(通)用件登記

描图

描校

旧底图总号	
-------	--

底图总号

签字

日期

P

1

1

1

1

外导体(Outer Contact

1

	L
--	---

8

						 成都恒利泰科技有限公司 Chengdu HenryTech Technology co., Ltd					
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年 月 日	阶 段		标 记	重 量	比 例	HL-SMA-JEP-1.6-02
设计			标准化								
校核			工艺								
主管设计			审核								
			批准			共1张		第1张	版本	替代	